

# 膜厚測定機

浜松ホトニクス社製厚み計を使用し、ワークに塗布されている膜の厚みを測定します。



## フルオート測定可能

レシピを選択することでワーク投入後はフルオートでの測定が可能です。

## クリーンユニット搭載

装置内のクリーン度を保持します。

## イオナイザー搭載

Waferへの帯電を防止します。

## 装置概要

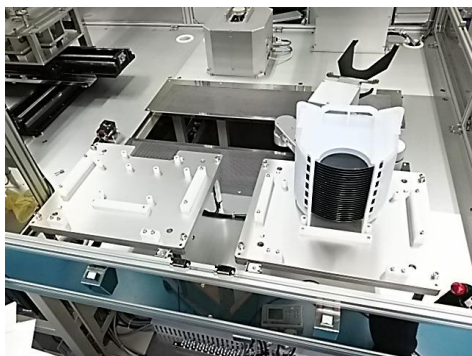
カセット投入

ワーク取出し

アライメント

膜厚測定

カセット排出



ローダー・アンローダー部

カセット単位でワークの投入・排出を行います。



搬送ロボット

ローダー部よりワークを取出し、各ユニットへ搬送します。



測定部

非接触型センサーを用いて膜厚測定を行います。



## PCメイン画面

### ・測定レシピ作成

ワークの大きさ・形状・測定箇所などを設定し、測定レシピを作成します。

### ・自動測定モード

自動測定モードでは、ワークが無くなるまで指定したレシピで自動測定を行います。  
(エラー発生時は、パトライト点滅・ブザー発報を行い、測定を停止します。)

### ・測定結果表示

測定結果をマップ形式で表示し、CSVデータとしてPC内に保存します。

■ 詳細仕様

装置仕様		
対応フレームサイズ	約 290 mm × 約 320 mm (角型の額縁形状)	
対応ウェハーサイズ	φ 200 mm (± 0.2 mm)	
装置サイズ	2400 mm (W) × 1910 mm (D) × 1855 mm (H)	
装置重量	約 1000 kg	
供給電源	3相 200V 15A	
供給AIR	0.4 MPa	
装置構成		
カセットステージ	ロード/アンロード兼用	
	搬送ロボットの搬送可能エリア内に2個設置	
	各カセットの着座検出センサ	
	各ワークの飛出し検出センサ	
センタリング 反転ユニット (フレーム専用)	センタリング方式	測定部にて左右・前後駆動のメカチャック方式
	位置決め (センタリング) 精度	± 0.1 mm
	位置決め時間	約 5 秒 (参考)
	反転部クランプ	左右駆動のメカチャック方式
	反転精度	180° ± 0.1°
	反転速度	約 5 秒 (参考)
アライメントユニット (Wafer専用)	位置決め精度 (センタリング)	± 0.3 mm以内
	位置決め精度 (ノッチロケート)	± 0.3度以内
	位置決め時間	約 5 秒以内
	Wafer保持	真空吸着
厚さ測定部	測定機 (浜松ホトニクス製)	Optical Nano Gauge C12562
	測定範囲	10 nm ~ 100 μm
	測定再現性	0.02 nm
	スポットサイズ	φ 1 mm以下
	測定可能膜層数	最大 10 層
	計測時間	3 ms / Point
	繰り返し位置決め精度 (ステージ)	± 0.01 mm
搬送ロボット部 (ダブルアーム式)	動作範囲 (上下ストローク)	300 mm
	動作範囲 (旋回角度)	340度
	動作範囲 (スライダーストローク)	560 mm
	繰り返し精度	± 0.2 mm以内
	ワーク検出	マッピングセンサ有り
	ワーク保持 (フレーム専用)	クランプ
	ワーク保持 (Wafer専用)	真空吸着
制御 (1)	PLC制御 (駆動関係)	
制御 (2)	PC制御 (メイン操作 / データ管理)	

※ 1 本内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。

※ 2 詳細については、弊社にご連絡ください。

販売元



株式会社ピクリング  
未来を形に。テクノロジーカンパニー

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町925番地  
TEL 045-633-7377  
FAX 045-633-7378